

# 極高真空システム

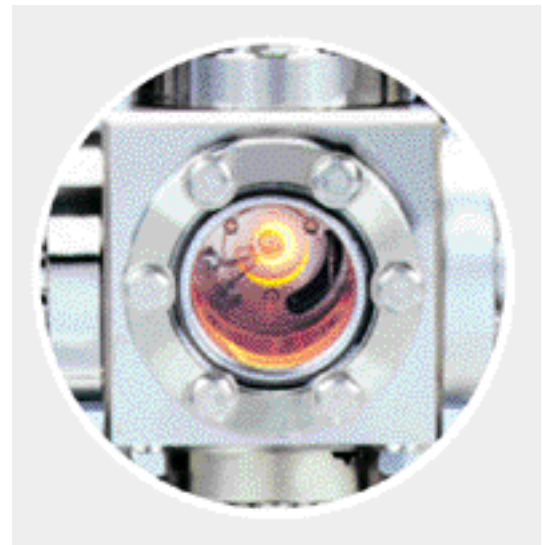
Copper alloy Extreme-High Vacuum system

## 特長

Features

低輻射率・高熱伝導率である。  
熱源からのガス放出を1/100まで軽減。  
特殊処理 (TOMI研磨)にて、超低ガス放出である。  
100 程度の低温ベークで $10^{-9}$ Pa台の超高真空を得られる。  
250 を超えるベーキングで容易に極高真空を得られる。  
従来のSUS製品に改良を加えることにより、この技術を応用してガス放出を抑えることが可能である。

Low radiation rate and high conductivity.  
Outgassing from the heat source was reduced to 1/100.  
Super low Outgassing is achieved by special treatment TOMI polishing.  
Ultra-High Vacuum of  $10^{-9}$ Pa level is obtained with low temperature baking at about 100 .  
In baking above 250 , an Extreme-High Vacuum is easily obtained.  
This technology controls Outgassing by adding certain improvement on the existing



## 仕様

Specifications

チャンバー寸法 Chamber size	80mmキュービックチャンバー 80 mm cubic chamber
ポートサイズ Port size	ICF 070 x 6
到達真空度 Ultimate Vacuum Pressure	$10^{-9}$ Pa台 (ターボ分子ポンプ接続時 $10^{-10}$ Pa台) $10^{-9}$ Pa level (when connecting a turbo molecule pump - $10^{-10}$ Pa level)
リーク量 Leakage rate	測定範囲限界外 Outside measurable limit
重量 Net weight	約 30kg About 30 kg
付属機器 Accessories	ローアウトガスタイプ質量分析計 Low out gas mass spectrometer
	エクストラクターゲージ Extractor gauge
	NEGポンプ NEG pump
	特殊イオンポンプ (弊社製) Special ion pump (Musashino Engineering Co., Ltd.)

お客様の仕様に応じて設計・製作致します。

A custom manufactured apparatus is offered based on customer specifications.